

各位

株式会社富山第一銀行

株式会社シンコーとの
「ファースト・ポジティブ・インパクト・ファイナンス」の契約を締結

株式会社富山第一銀行（頭取 野村 充）は、株式会社シンコー（代表取締役 中川 真太郎）を評価対象とした「ファースト・ポジティブ・インパクト・ファイナンス」の契約を締結いたしましたのでお知らせします。

本サービスを通じて、取引先の企業活動における環境・社会・経済の3つの側面に対して、インパクトを包括的に特定・分析し、ポジティブインパクトが期待できる活動と、ネガティブインパクトを低減する活動を支援いたします。

今後も、お客さまに「寄り添う」銀行として、持続可能な社会の実現に向けた企業活動を通じたSDGsの達成に寄与することで、さらなる信認につなげます。

記

1. 商品概要

本商品は、企業活動が経済・環境・社会に与えるポジティブ並びにネガティブな影響をポジティブインパクト金融原則に基づき特定し、ポジティブインパクト（プラスの影響）を拡大、ネガティブインパクト（マイナスの影響）を緩和することでSDGs達成を目指すファイナンスの取組です。当行は、インパクトに対する企業活動の影響・取組を包括的に分析・評価を行います。これらのインパクトに対するKPI（重要業績評価指標）についてお客さまとともに設定し、達成状況や取組状況について、定期的にモニタリングし、達成に向けて支援を行ってまいります。客観性を保つため当行が実施した評価について株式会社格付投資情報センターより第三者意見を取得しています。

2. 融資概要

契約締結日	2023年9月29日
借入人	株式会社シンコー
融資金額	200百万円
資金使途	運転資金
モニタリング期間	5年

※株式会社格付投資情報センター（R&I）のセカンドオピニオンは、下記URLをご参照ください。
<https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html>

3. 評価企業概要 株式会社シンコー

代表者	代表取締役 中川 真太郎
本社所在地	富山県富山市馬瀬口90番地
事業内容	産業用機械向け金属部品製造業
設立年月日	1981年5月13日

4. SDGs達成に向けた取組事例（詳細は評価書をご参照ください）

取組内容	半導体製造装置フレームの供給を通じた経済・社会への貢献
インパクトの種類	社会面・経済面におけるポジティブ・インパクトの拡大
インパクト・カテゴリ	「情報」「包括的で健全な経済」
関連SDGs	 
対応方針	半導体製造装置フレームの供給拡大 品質の高い製品供給を行うための社内体制整備
毎年モニタリングする目標とKPI	<ul style="list-style-type: none"> ・2028年5月期までに売上高15%増加 (2023年5月期 売上高：4,761百万円)



株式会社シンコー
代表取締役
中川 真太郎 氏

株式会社富山第一銀行
本店営業部長
上野 嘉介

【本件に関する問い合わせ先】

法人事業部：中山
TEL 076-461-3871

ポジティブ・インパクト・ファイナンス評価書

評価対象企業：株式会社シンコー



2023年9月29日

株式会社 富山第一銀行

目次

1. はじめに	2
2. 会社概要	3
(1) 会社概要	
(2) 沿革	
(3) 企業理念・品質方針・環境方針	
(4) 組織体制	
3. 事業概要	6
(1) バリューチェーン	
(2) 半導体業界	
(3) 生産拠点	
(4) 生産設備	
(5) 業務フロー	
(6) 当社の技術・強み	
4. 職場環境	10
(1) 健康経営優良法人・とやま健康企業宣言	
(2) えるぼし（3つ星）認定	
(3) 地域未来牽引企業	
(4) 資格取得支援の取り組み	
(5) 工場見学/インターンシップ	
5. 環境問題への取り組み	17
(1) 環境目標	
(2) 富山県SDGs宣言	
(3) 地域貢献活動	
6. インパクトの特定	19
(1) インパクトリーダーによるマッピング	
(2) インパクトカテゴリーに対応するSDGsのゴール	
(3) 日本におけるインパクトニーズの確認	
(4) インパクトの特定	
(5) 特定したインパクトと富山第一銀行との方向性の確認	
7. KPIの設定	23
8. 管理体制とモニタリング	26
(1) インパクトの管理体制	
(2) モニタリング方法	

1. はじめに

株式会社富山第一銀行は、株式会社シンコーに対してファースト・ポジティブ・インパクト・ファイナンス（以下、ファーストP I F）を実施するにあたって、同社の事業活動が、環境・社会・経済に及ぼすインパクト（ポジティブな影響及びネガティブな影響）を分析・評価した。

分析・評価にあたっては、株式会社格付投資情報センターの協力を得て、国連環境計画金融イニシアチブ（UNEP FI）が提唱した「ポジティブ・インパクト金融原則」およびESG金融ハイレベル・パネル設置要領第2項（4）に基づき設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンスの基本的な考え方」に則った上で、株式会社シンコーの事業活動における包括的なインパクトを分析した。

株式会社富山第一銀行は、本評価書で特定されたポジティブ・インパクトの拡大とネガティブ・インパクトの緩和に向けた取組を支援するため、株式会社シンコーに対し、ポジティブ・インパクト・ファイナンスを実行する。

資金調達者の名称	株式会社シンコー
所在地	富山県富山市馬瀬口90番地
従業員数	199名（2023年8月時点）
事業内容	産業用機械向け金属部品製造
調達金額	200,000,000円
調達形態	証書貸付金
資金使途	運転資金
契約期間（モニタリング期間）	2023年9月29日～2028年9月23日

2. 会社概要

(1) 会社概要

社名	株式会社シンコー
代表者	代表取締役 中川 真太郎
本社	〒939-1301 富山県富山市馬瀬口90番地
設立年月日	1981年5月13日
事業内容	産業用機械向け金属部品製造
資本金	43.5百万円
売上高	4,761百万円 (2023年5月期)
従業員	199名(2023年8月時点)

(2) 沿革

	概要
1979年	個人創業
1981年	有限会社 新光製作所 設立
1989年	株式会社 シンコー に社名変更
1991年	建材加工部門設立 中小企業モデル工場認定
1998年	機械加工工場を設立
2001年	大型機械加工部門を設立
2003年	ISO9001 2000取得
2007年	ISO14001 2004取得
2008年	製缶部門を設立
2010年	CS1工場 (コントロールセンター) を設立
2012年	外国人研修生受入開始
2016年	外国人技術生採用開始
2017年	CS 2 工場設立
2018年	婦中工場稼働開始 (組立専用工場)
2019年	CS 3 工場設立 富山県に「とやま健康企業宣言」を表明
2020年	経済産業省より地域未来牽引企業の認定企業に選出される
2021年	富山県SDGs宣言企業に登録
2022年	健康経営優良法人2022取得 富山県 とやま健康経営大賞受賞 リフレッシュ施設設立 (ヨガ、ピラティス、ボクササイズ)
2023年	健康経営優良法人2023取得 えるぼし (3つ星) 認定

2. 会社概要

(3) 企業理念・品質方針・環境方針

企業理念

富山から最先端のモノづくり

Challenge & Effort

- ▶ お客様のニーズに応え、信頼性の高い製品とサービスを提供し、「ものづくり」に挑戦する。
- ▶ 働くスタッフひとりひとりの可能性や個性を生かし、体と心の健康を保ち、明るい会社づくりをする。
- ▶ 地域の活動や社会問題に取り組み、貢献する。

品質方針

2000年にISO9002を取得、2003年にISO9001を取得。

顧客の期待する製品を供給することを最優先の目的として、継続的改善を行う為に以下の品質方針を定める。

- ▶ 顧客の信頼と満足を得る品質を定める。
- ▶ 品質の高いより良い製品とコスト追及により、納期を守り、顧客に提供する。

環境方針

当社は、事業活動の中で人間と地球の最適な関わり合いを追及し、下記項目の環境活動を行う。当社の事業活動の中で環境に対して影響の大きい項目については技術的、経済的に可能な範囲で目標を設定し、環境マネジメントシステムの継続的改善及び環境汚染の予防を図る。

- 01 環境側面に関連する適用可能な法規制及び当社が同意するその他の要求事項を遵守します。
- 02 地球環境の保全に関する社内規定を整備し、管理の向上を図ります。
- 03 環境目的及び目標を徹底し、定期的にレビューし環境負荷の継続的な低減に努力します。
- 04 全社員に対し環境教育を徹底し、環境保護の意識向上を図り、環境保全活動に取り組みます。
- 05 廃棄物の減量化に取り組みます。
- 06 省資源、省エネルギーに取り組みます。
- 07 この環境方針は、全社員へ周知徹底するとともに、社外へも公表します。

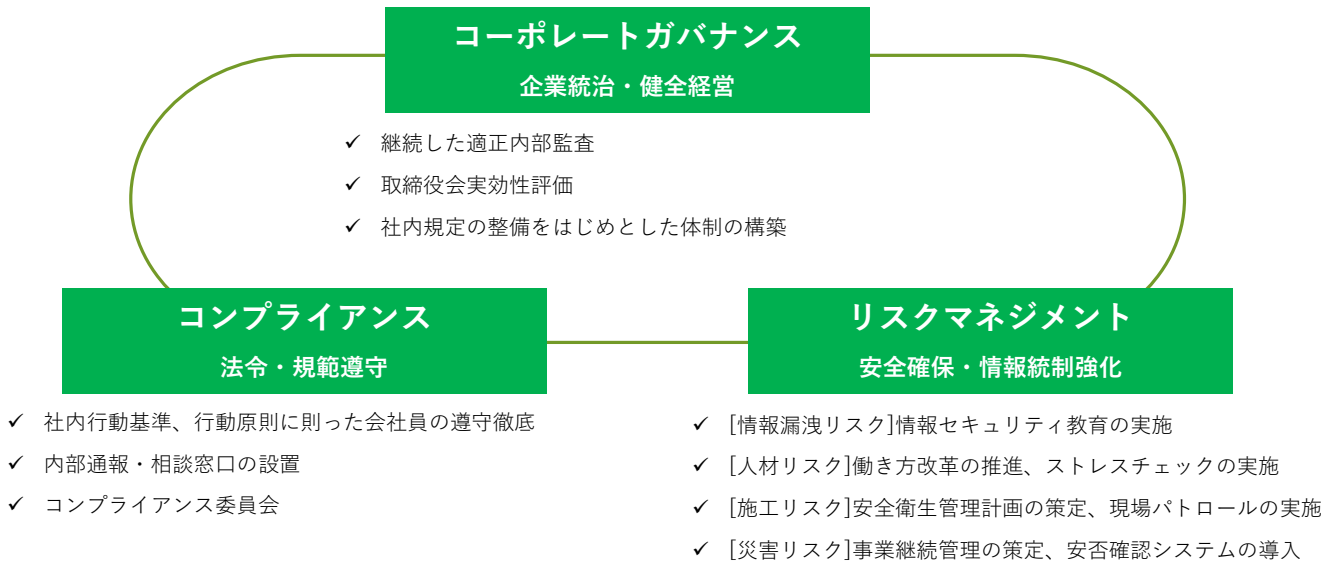


ISO9001:2022 認証取得
ISO14001:2022 認証取得

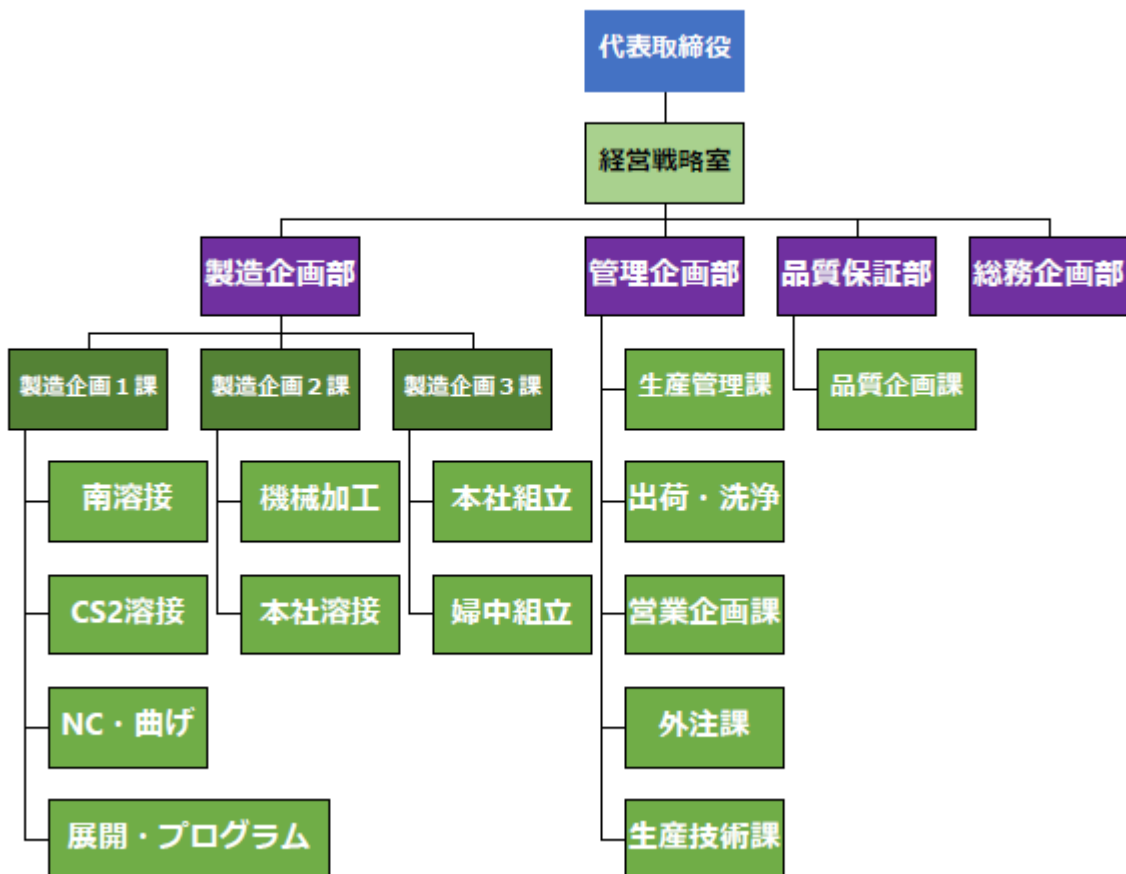
2. 会社概要

(3) 組織体制

高い倫理観と公平性に基づいた健全な企業活動が極めて重要であると考えており、経営および業務の全般にわたり、透明性の確保とし、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等、すべてのステークホルダーの皆さまからの信頼に応じて、効率的な経営を持続していくために、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実に取り組んでいる。

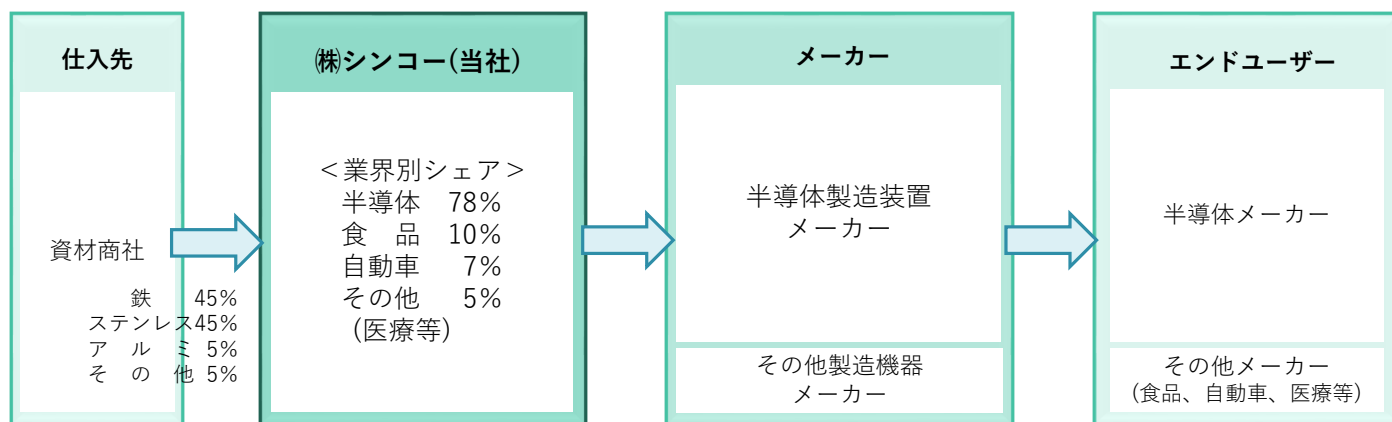


組織図



3. 事業内容

(1) バリューチェーン



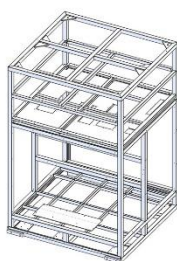
当社は昭和54年創業の精密板金メーカーであり、鉄、ステンレス、アルミ等の素材にて、半導体製造装置や食品検査機、医療検査機など産業機械の金属部品を製造している。社内設備の充実と工場の拡張を継続して実施し、設計、加工、組立、品質保証に至る一貫生産体制を確立している。

板金の鍛圧、鋼材の溶接組立をコア技術に主力製品として産業用機械全体のフレームを生産しており、そのうち半導体製造装置主要フレーム、部品は当社の売上高の約8割を占める。当社にて同フレームに製作した部品を組付し、最終的には取引先メーカーにて半導体製造装置となる。当社の納入する製品は半導体製造において不可欠なモノであり、世界的な半導体増産の市場動向となる中で、当社の取引先である半導体製造装置メーカーからは今後更なる増産要請を受けている。

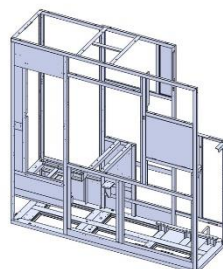
<製造製品例>

半導体製造装置

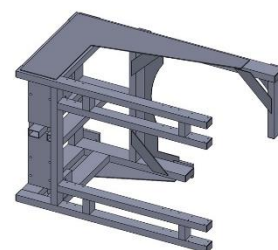
Semiconductor Machinery



製造装置筐体



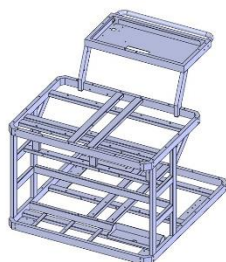
換気システム



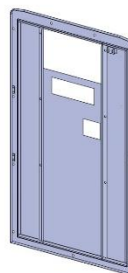
治具脱着ユニット

産業用機械

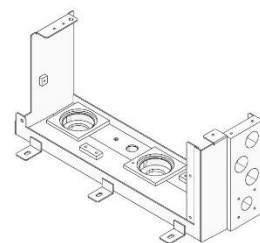
Industrial Machinery



アルミ角パイプフレーム



アルミ精密板金



ステンレス機密部品

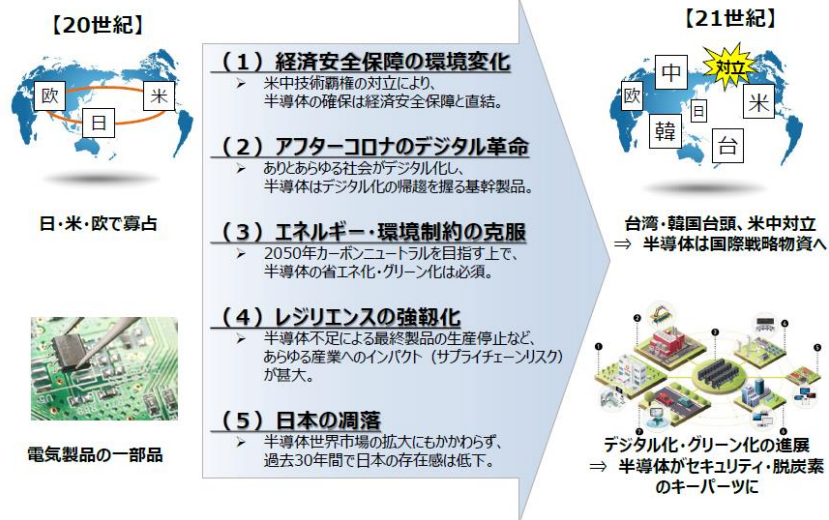
3. 事業内容

(2) 半導体業界

DXの実現や、人手不足、GX、経済安保等の社会課題の解決にはAIをはじめデジタル技術の活用が重要であり、半導体はその産業基盤として必要不可欠なものである。しかしながら、世界における半導体市場の拡大にもかかわらず、過去30年間で日本の存在感は低下してきた。

また近年は、米中貿易摩擦やコロナショック、ロシアによるウクライナ侵攻により、部品や部材調達サプライチェーンが分断され、在庫の極小化やコスト競争力のある海外での集中生産のリスクが顕在化した。

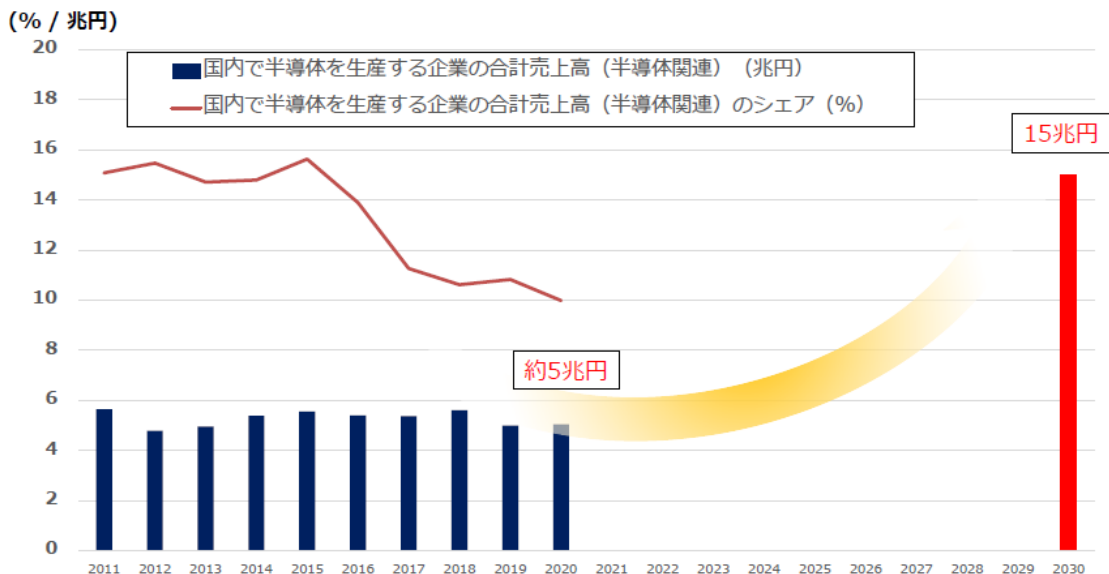
半導体を巡るグローバルな構造変化



そういった状況下で、2023年5月に開催された広島サミットでは、G7による「強靱で信頼性のあるサプライチェーンに関する原則」を表明し、半導体等の重要物資について、世界中のパートナーシップを通じて、サプライチェーンを強化していく旨を合意した。

世界各国・地域が半導体産業の投資拡大に向けた異次元の支援策を実施しており、日本においても、2021年6月に策定した「半導体デジタル産業戦略(経済産業省)」を、2023年6月の戦略改定により、これまでの取り組みの幅を広げ、戦略の中身を具体化している。

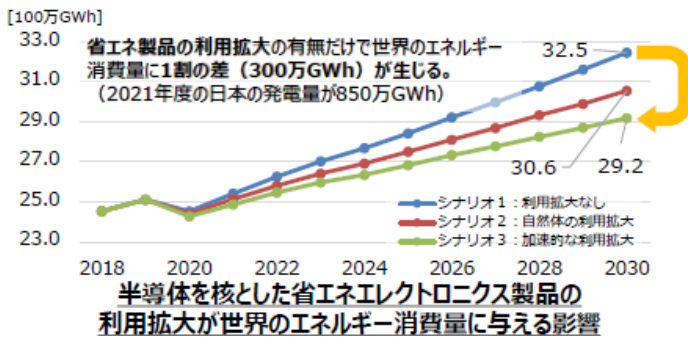
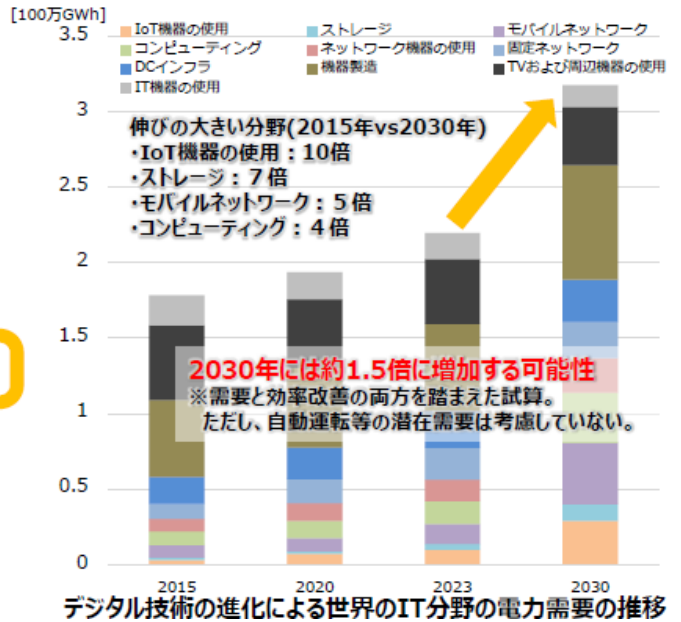
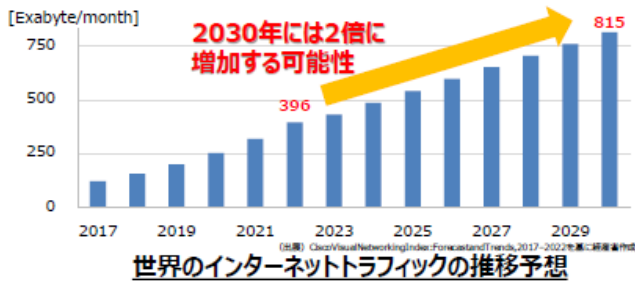
2030年の世界の半導体市場は2021年の1.8倍となる1兆ドルまで拡大すると予想される中、日本においては2020年では5兆円であった半導体国内生産の売上高を、2030年には15兆円とする目標を掲げ、国内における半導体の安定供給を実現させる方針である。



(出典：経済産業省 半導体デジタル戦略 令和5年6月)

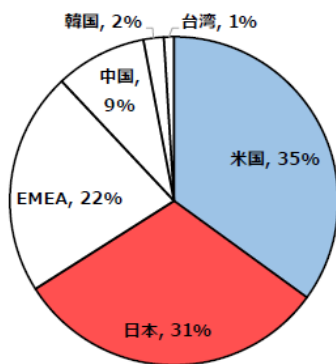
3. 事業内容

一方で、デジタル技術の活用拡大は電力消費の増加を引き起こすものであり、気候変動が国際的な課題となる中、半導体の進化によるエネルギー消費の抑制により、デジタル化と脱炭素化の両立（GX）を進めることを目指すべき方向性としている。



半導体製造にあたっては合計1,000以上の工程が必要であり、高度かつ繊細な技術力が求められる中で、半導体製造装置産業では世界の約3割のシェアを日本企業が占めている。また「半導体・デジタル産業戦略」において、半導体製造装置の今後の目標・戦略として、ステップ1：製造装置の国内体制強化、ステップ2：先端半導体の製造やパッケージ技術の実現に必要な装置技術の開発、ステップ3：クリーン・グリーン製造を実現する装置技術の開発とし、半導体製造装置の国内供給体制を強化していく方針である。

半導体製造装置 各国シェア



今後の半導体戦略の全体像①

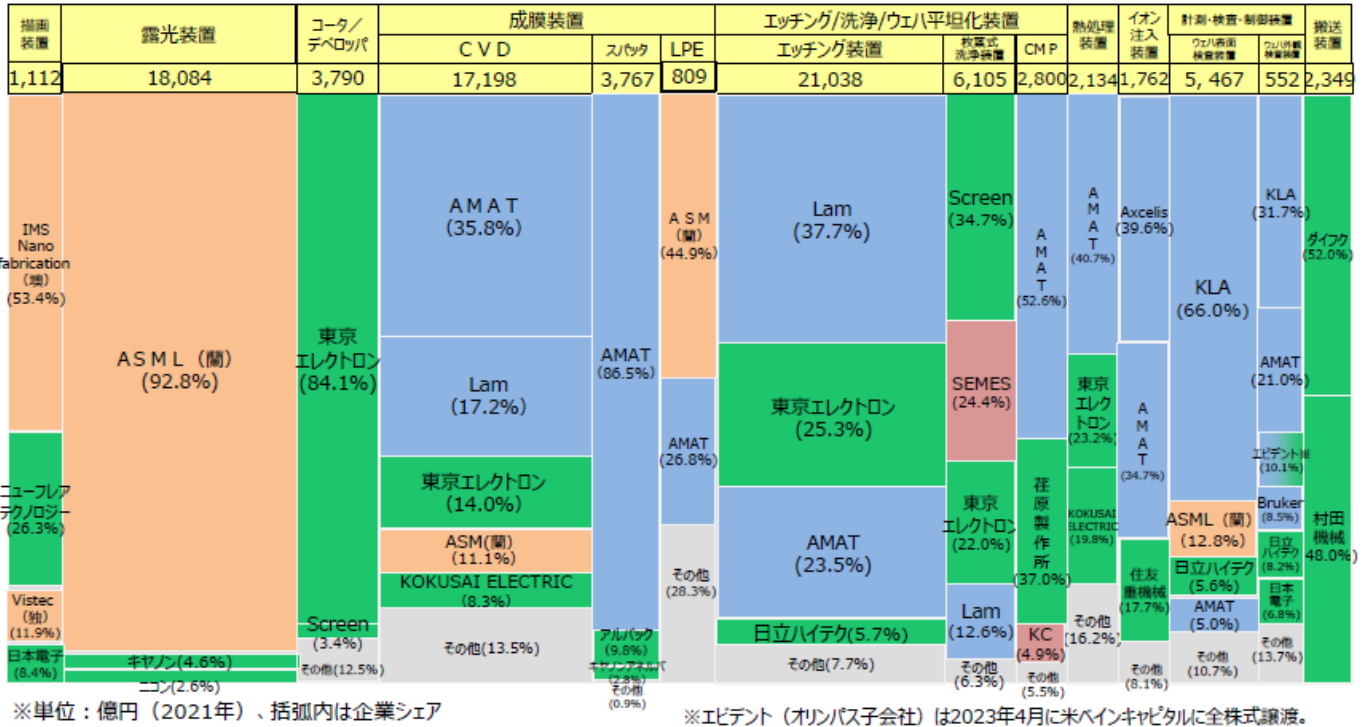
	ステップ1 足下の製造基盤の確保	ステップ2 次世代技術の確立	ステップ3 将来技術の研究開発
先端ロジック半導体	<ul style="list-style-type: none"> 国内製造拠点の整備・技術的進展 	<ul style="list-style-type: none"> 2 nm世代ロジック半導体の製造技術開発 → 量産の実現 Beyond 2nm 実現に向けた研究開発 (LSTC) 	<ul style="list-style-type: none"> Beyond 2nm 実現に向けた研究開発 (LSTC) 光電融合等ゲームチェンジャーとなる将来技術の開発
先端メモリ半導体	<ul style="list-style-type: none"> 日米連携による信頼できる国内設計・製造拠点の整備・技術的進展 	<ul style="list-style-type: none"> NAND・DRAMの高性能化 革新メモリの開発 	<ul style="list-style-type: none"> 混載メモリの開発
産業用スベチャリティ半導体	<ul style="list-style-type: none"> 国内での連携・再編を通じたパワー半導体の生産基盤の強化 エッジデバイスの多様化・多機能化など産業需要の拡大に応じた用途別従来型半導体の安定供給体制の構築 	<ul style="list-style-type: none"> SiC/パワー半導体等の性能向上・低コスト化 	<ul style="list-style-type: none"> GaN・Ga₂O₃パワー半導体の実用化に向けた開発
先端パッケージ	<ul style="list-style-type: none"> 先端パッケージ開発拠点の設立 	<ul style="list-style-type: none"> チップレット技術の確立 	<ul style="list-style-type: none"> 光チップレット、アナデジ混載SoCの実現・実装
製造装置・部素材	<ul style="list-style-type: none"> 先端半導体等の製造に不可欠な製造装置・部素材の安定供給体制の構築 	<ul style="list-style-type: none"> Beyond 2nmに必要な次世代材料の実用化に向けた技術開発 	<ul style="list-style-type: none"> 将来材料の実用化に向けた技術開発

10

(出典：経済産業省 半導体デジタル戦略 令和5年6月)

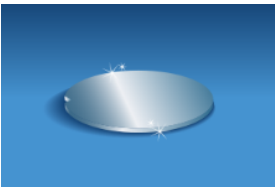
3. 事業内容

半導体製造装置製造は、日本企業が世界シェアの約3割を占めており、各工程の製造装置で日本企業が存在する。市場規模が大きい装置はアメリカ（青色）、オランダ（橙色）の企業が占めるが、日本企業（緑色）が高いシェアを占める装置も多く存在する。

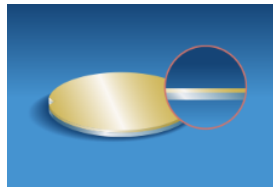


（出典：経済産業省 半導体デジタル戦略 令和5年6月）

【半導体製造工程】



1. 洗浄
半導体の基となるシリコンウエハの洗浄



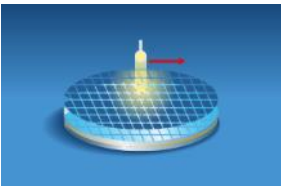
2. 成膜
ウエハ上に回路の素材となる酸化シリコンやアルミニウムなどの薄膜を形成する



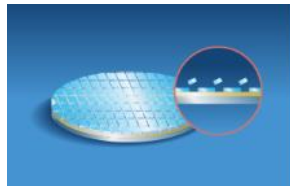
3. 成膜後洗浄
成膜後に付着した微細なパーティクルを物理洗浄で除去する



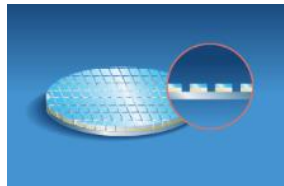
4. レジストコーティング
レジスト(感光液)をウエハ表面に塗装し、遠心力でレジスト膜を形成する



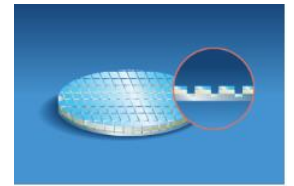
5. 露光
回路パターンが描画されたマスクを通して遠紫外線を照射し、パターンを転写する



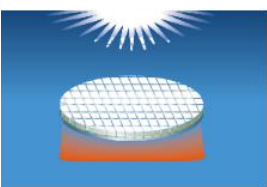
6. 現像
現像液を吐出してウエハ上の露光された部分を溶かし、薄膜の表面を露出させる



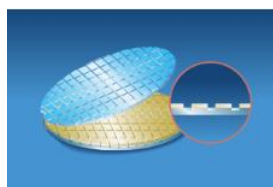
7. エッチング
フッ酸、リン酸などの薬液で露出した薄膜を腐食し、除去する



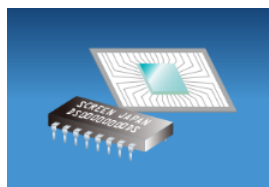
8. 不純物注入
シリコン基板上に半導体の特性を持たせるため、不純物イオンをウエハに注入する



9. 活性化
注入した不純物イオンを活性化させるため、フラッシュランプやレーザー照射による熱処理をする



10. レジスト剥離
薬液で隔離する方法と、ガスで化学反応させてレジストを灰化方法がある



11. 組み立て
一つ一つのチップに切り分け、リードフレーム(金属枠)に金線で接続し、プラスチック製の樹脂で封入する。

（出典：(株)SCREENホールディングスHP）

3. 事業内容

(3) 生産拠点

CS1工場・CS2工場

当社のメインファクトリー。パイプ加工、曲げ加工、レーザー溶接や設計などの事業の中核プロセスを受け持つ。



CS1工場



CS2工場

主な製造工程

- ・レーザー板金加工
- ・レーザー加工
- ・折り曲げベンディング加工
- ・角・丸パイプレーザー加工
- ・SUS溶接加工
- ・レーザー溶接加工
- ・洗浄工程



設計室



パンチング・パイプレーザー加工



ベンディング加工スペース



ミーティングスペース

本社工場・CS3工場

主に筐体関連の溶接組立、仕上げを行う。



本社工場



CS3工場

主な製造工程

- ・筐体溶接組立
- ・筐体仕上げ加工
- ・筐体組立て
- ・機械部品加工

南工場

大型筐体の機械加工・溶接を行う。2022年にリフレッシュ施設（ヨガ、ピラティス、ボクササイズ）、研修棟を設立。



南工場

主な製造工程

- ・板金筐体溶接組立
- ・大物洗浄
- ・筐体仕上げ加工
- ・機械部品加工
- ・部品払い出し作業

本社工場・CS3工場

筐体部品出荷の拠点。



婦中工場

主な製造工程

- ・筐体部品出荷

3. 事業内容

(4) 生産設備

板金設備		
名称	メーカー／形式／仕様	台数
レーザープレス複合機	<ul style="list-style-type: none"> •AMADA EML3610NT (～6.0mm 1500mm × 3000mm) •AMADA C1 (～6.0mm 1500mm × 3000mm) 	各1台
レーザープレスセルライン	<ul style="list-style-type: none"> •AMADA ACIES2515T(179)+AS_ULS3015NTK (6.0mm 1250mm × 2500 mm) •AMADA ACIES2515T(300)CP+AS_ULS3015NTK (6.0mm 1250mm × 2500 mm) 	各1台
レーザ加工機	<ul style="list-style-type: none"> •トルンプ T5030 10Kw (～t30 1500mm × 3000mm) •トルンプ T3030 6Kw (～t25 1500mm × 3000mm) 	各1台
コーナーシャー	<ul style="list-style-type: none"> •竹田機械 TCN-256 (6.0mm) 	1台
プレスブレーキ	<ul style="list-style-type: none"> •AMADA RG25 (25t 1200mm) •AMADA RG35 (35t 1200mm) •AMADA EG6013 (60t 1350mm) •AMADA HD1303L (130t 3000mm) •AMADA HDS5020 (50t 2070mm) •AMADA HDS8025 (80t 2500mm) •AMADA HDS1303 (130t 3000mm) •AMADA HDS1703 (170t 3110mm) •AMADA HG8025 (80t 2600mm) •AMADA HG5020 (50t 2150mm) 	各1台
ハイブリッドドライブベンダー	<ul style="list-style-type: none"> •AMADA HG2204ATC (220t 4000mm) •AMADA HG1003ARS (100t 3000mm) ロボット搭載 •AMADA HG1003ATC (100t 3000mm) 	各1台
NC スタッド溶接機	<ul style="list-style-type: none"> •AMADA GUNMAN-1002 (ワークサイズ：1100mm × 1000mm) 	2台
溶接機	<ul style="list-style-type: none"> •TIG溶接機 •半自動溶接機 	60台 60台
YAGレーザー溶接機	<ul style="list-style-type: none"> •日本ウエルディングハンディレーザー 500W 	2台
ディスクレーザー溶接機	<ul style="list-style-type: none"> •トルンプ 5kw (ロボットタイプ 2ポジションナー) •トルンプ 6kw (ロボットタイプ 2ポジションナー) 	各1台
テーブルスポット溶接機	<ul style="list-style-type: none"> •AMADA TS-86K (1000mm × 800 mm (銅盤)) •AMADA TS-80K (1000mm × 800 mm (銅盤)) 	2台 1台
ロボット溶接機	<ul style="list-style-type: none"> •ダイヘン 	3台

3. 事業内容

機械加工設備		
名称	メーカー／形式／仕様	台数
五面加工機	<ul style="list-style-type: none"> ・OKUMA MCR-A5C (X4000 × Y 2000) ・三菱重工 MCR30 (X4000 × Y 2000) ・OKUMA MCR-B II (X3800 × Y2500) ・OKUMA MCR-A5C (X3000 × Y1500) ・OKUMA MCR-A (X3000 × Y1500) ・OKUMA MCV-A II (X3800 × Y1500) ・OKUMA MCR-A5C II (X3000 × Y1500) ・OKUMA MCR-A5C II (X4000 × Y2000) 	1台 1台 2台 2台 1台 1台 1台 3台
マシニング	<ul style="list-style-type: none"> ・イワシタ機械 IMT1230 (X1200 × Y3000) ・イワシタ機械 IMT1231 (X1200 × Y3000) 	2台 3台
横型マシニング	<ul style="list-style-type: none"> ・コマツNTC N5H1086 (X850 × Y850) 	1台
横フライス	<ul style="list-style-type: none"> ・イワシタ NH2-1 	1台
マシニングセンター	<ul style="list-style-type: none"> ・OKUMA MB-56VB (X1050 × Y540) ・OKUMA MB-66VB (X1500 × Y660) ・OKUMA MILLAC (X3050 × Y850) ・MAZAK 2000L/120 (X3000 × Y510) 	1台 2台 1台 2台
旋盤	<ul style="list-style-type: none"> ・OKUMA L250H (オイルマガジンバーフィーダ3m) ・OKUMA LB2000 (オイルマガジンバーフィーダ3m) 	各1台
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・汎用機 イワシタ NH2-1 ・汎用機 OKK らくらくミル ・切断機 AMADA HFA250 	各1台

パイプ加工設備		
名称	メーカー／形式／仕様	台数
パイプレーザー加工	<ul style="list-style-type: none"> ・トルンプ Tube5000 (丸パイプ：φ150 角パイプ：125 × 125) ・トルンプ Tube7000 (丸パイプ：φ250 角パイプ：175 × 175) ※オプション使用時 ・トルンプ Tube7000 (丸パイプ：φ150 角パイプ：125 × 125) 	各1台

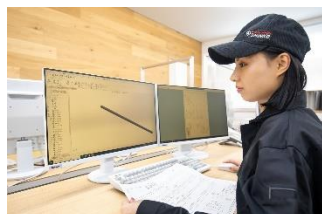
3. 事業内容

(5) 業務フロー

当社では、設計提案からプレス、機械加工、組立までをすべて自社で行う「一貫生産体制」を確立しており、相談、見積もりから製作、出荷までワンストップ且つスピーディな納品を可能としている。



01 ご依頼・打ち合わせ
ご依頼内容の詳細打ち合わせ、見積書作成



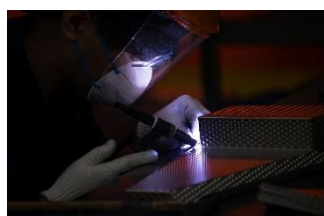
02 展開図・プログラム作成
受注図面から3DCAD図面を製作、完成品イメージの社内共有



03 材料切断
自動収納庫付き最新鋭ファイバーレーザー加工機にて材料切断



04 曲げ加工
ロボットによる全自動ペンディングマシン、自動金型ペンディングマシンにて安全で効率的な曲げ加工



05 溶接加工
最新鋭のYAGレーザーからロボット溶接機までマテリアルを熟知した60名を超える熟練溶接スタッフによる溶接



06 機械加工(仕上げ加工)
大型五面加工機を13台保有し、大型の筐体も精密な機械加工が可能



07 検査
3次元測定器などにより、高精度の要求に応える



08 塗装・めっき処理
当社協力工場との協調により



09 洗浄
半導体洗浄工場・食品・薬品工場で使用される部品をクラス100000の環境で洗浄



10 サブアッセンブリ組立
サブアッシー、装置組立にも対応



11 工場出荷
丁寧に梱包し、自社ルート便にて迅速な配送体制で届ける

3. 事業内容

(6) 当社の技術・強み

当社では、最先端の生産設備や自動ロボット設備などを活用し、生産の効率化と業務改善に取り組んでおり、人の手で加工する技術力とIoTを融合した金属加工が強みである。

半導体製造装置フレームは高い精度と高剛性が要求される。このフレームには大型の製造機器が組付けられるため、フレームの精度により組付け・調整時間に大きな影響を及ぼすこととなる。溶接精度は1mm以下、5/100mmを立体造形物で確保する技術が必要であり、人の手による熟練の技術と、最先端の設備により高い精度を実現している。

当社製品の仕上がり精度は、以下の技術・強みにより実現可能としている。①溶接前部材の精度、②組立精度、③最適な溶接手法の選定(レーザー、TIG、CO2半自動溶接等)、④溶接による部材のひずみ(熱膨張等)を取る生産技術の高さ、⑤門型マシニングセンタによる加工技術、これらが当社のコア技術となり、他社との差別化を進化させてきた。



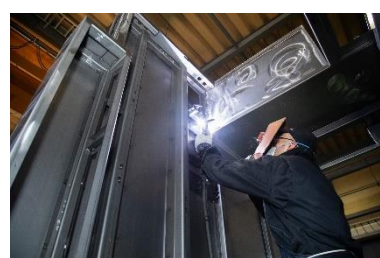
試作品をTIG溶接で組立

レーザー溶接、TIG(不活性ガス)溶接、CO2半自動溶接等、部品に最適な溶接方法を提案



レーザー溶接

レーザービームによって金属を融解させて接合させる。高精度な加工ができ電子部品などの小さなワークも対応可能



大型筐体の溶接組立

大型の板金筐体、角パイプ筐体など量産品から試作品まで高精度な製作を行う



5面で仕上げる

5面加工機を13台保有し、難削材から鉄まで対応し、一時固定が出来ない場合も治具から設計する



NCベンダーで単品加工

曲げ精度が安定しているサーボモーター駆動による油圧ハイブリッド制御のプレスブレーキ(ベンダー)を多数保有



400バフ研磨

バフホイールを高速で加点させる機会に装着し、バフに製品を当てることで研磨する

<BCP対応>

当社は、事業継続力強化計画の認定を受けており、自然災害発生時の人命・安全の確保、情報資産の保全、自社の経営維持・取引先への影響軽減を目的としている。

自然災害発生時における製品供給を確保するため、非常時の備えとして「情報セキュリティシステム取扱手順書」「情報セキュリティシステム利用手順書」の手順に従い、サーバーデータのバックアップ及びデータの保管を行う。また「情報セキュリティマニュアル」に従い、定期的に監視・レビューを行い有効性の確認を行っている。

また当社の製造が停止した場合を想定し、県内外での製造が行えるよう他社との緊急対策連携をし、生産できるよう体制を整えている。

4. 職場環境

当社は、従業員一人一人がやりがいと誇りをもって働きながら地域社会に貢献する、未来を切り拓くオンリーワン企業を目指している。そのため、「現場第一主義」を掲げ、従業員の声や企画提案を積極的に取り入れ、「心と体の健康を大切に、楽しく働ける職場環境づくり」に向けて、様々な取り組みを実践している。

(1) 健康経営優良法人・とやま健康企業宣言「銀」(Step 1)の認定

当社は、経済産業省より健康課題に対し特に優良な健康経営を実践している企業を顕彰する「健康経営優良法人」の認定を受けている。また、健康企業宣言富山推進協議会より社員の健康づくりを戦略的に取り組む企業を認定する「とやま健康企業宣言 銀」の認定を受け、最上位である「金」の認定に向けて宣言を実施した。

【主な取り組み】

- ・ 有給休暇の取得推進
- ・ ノー残業デーの取り組み推進
- ・ 禁煙講習、社内禁煙デーの実施
- ・ 運動・リフレッシュ施設の設置
- ・ 社内アクティビティ活動の実施
- ・ AEDの設置、講習の実施
- ・ 外傷対応講習会の実施



健康経営優良法人



とやま健康企業宣言



禁煙講習



AED講習



ヨガ教室



アロマ作り教室

(2) えるぼし (3つ星) 認定

当社は、厚生労働省より女性活躍推進法に基づく女性活躍に取り組む企業として、「えるぼし認定」で3段階ある最上位の3つ星を、富山県内の製造業金属加工業において初めて認定された企業である。

【主な取り組み】

- ・ 育児休業の取得推進 (2022年実績100%)
- ・ 育児時短勤務制度の整備
- ・ ハラスメント講習の実施
- ・ 女性管理職育成を目的としたキャリア研修



えるぼし認定

4. 職場環境

(3) 地域未来牽引企業

当社は、地域経済の中心的な担い手になる企業として、経済産業省より「地域未来牽引企業」に認定されている。選定された企業には、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の経済を牽引する、地域の中核企業としての期待が込められている。当社としても積極的な事業展開により、今後更なる地域貢献を目指している。



(4) 資格取得支援の取組み

当社は、キャリアアップできる体制づくりとして、社内独自の研修プログラムに加えて、資格取得支援制度を制定している。業務に必要とされる免許・資格は全て会社負担で取得することができ、取得者には資格取得手当を支給し、社員のスキルアップ・キャリアアップの支援に積極的に取り組んでいる。



(5) 工場見学/インターンシップ

当社は、高校生の工場見学やインターンシップの受け入れを幅広く行っている。受入者には、実際にものづくり体験をして頂くことで、当社のみならず製造業への関心・理解が深まり、将来的な業界全体の活性化に繋がることを目指し、取り組みを継続していく。



5. 環境問題への取り組み

(1) 環境目標

当社は、環境マネジメントシステムにおいて、「部門環境実施計画兼進捗管理書」により以下の環境目的及び目標、具体的な活動項目・内容を設定している。それぞれの項目において推進責任者により、社内への周知徹底、毎月の進捗管理・評価を行い、環境負荷低減に取り組んでいる。

環境目的	2023年度目標	活動項目・内容
電気使用量の削減 (3工場使用量の合計値)	2022年度比3%削減(原単位) 2022年度の実績を基に取り組み	<ul style="list-style-type: none"> 使用していない機器・照明の電源OFF エアコンフィルターの定期的な清掃
産業廃棄物の削減 (不適合再手配品で積算)	2022年度比3%削減(原単位) 2022年度の実績を基に取り組み	<ul style="list-style-type: none"> 不適合再手配品の削減 物流に使用する梱包材の変更 資源ごみのリサイクル回収徹底
OA紙使用量の削減 (3工場使用量の合計値)	2022年度比3%削減(原単位) 2022年度の実績を基に取り組み	<ul style="list-style-type: none"> 電子媒体の活用 両面コピーの推進 会議等でのプロジェクターの活用推進
ガソリン・軽油使用量の削減	2022年度比3%削減(原単位) 2022年度の実績を基に取り組み	<ul style="list-style-type: none"> 乗車前の車両点検 急発進・急加速の禁止

(2) 富山県SDGs宣言

富山県SDGs宣言



富山県SDGs宣言実施状況報告書

様式第3号



2023年4月19日

企業・団体名 株式会社シンコー

代表者名 中川真太郎

株式会社シンコーはSDGsの達成のため、以下について取り組むことを宣言します。

環境に配慮したモノづくりを進める一方で、雇用形態の多様化と健康経営を推進しながら社員、お客様等全ての関係者に明るさを提供出来るように、努力と挑戦を進める。

No.	取組目標及び主な取組み	SDGsゴール
1	<p>【目標】地球環境に考慮した現場内のムリ、ムダ、ムラの削減に努める。</p> <p>【主な取組み】 ・製品搬送時の積み方を改善し、1日当たりの運搬回数を低減させる。 ・製品梱包に使用するフィルムの使用量削減に向けて、資材梱包の発注回数を抑制する。</p>	
2	<p>【目標】生産現場における女性が活躍できる環境づくりに努める。</p> <p>【主な取組み】 ・30年度末までに育児休業の係る社内規則等の整備を行う。 ・ライフスタイルに合った働き方や雇用を実現させるために就業規則を改定する。</p>	
3	<p>【目標】社員が心身の健康を保ち、長く働き続けられる環境づくりに努める。</p> <p>【主な取組み】 ・社内に運動及びリフレッシュ施設を設置する等、一人ひとりが健康的に仕事を続けられる環境を整備する。</p>	

2021年 11月 26日
企業・団体名 株式会社シンコー
代表者名 代表取締役社長 中川真太郎

富山県SDGs宣言において宣言した取組みの実施状況について、下記の通り報告します。

記

1 取組み期間 令和4年4月1日～令和5年3月31日

2 取組みの実施状況

No.	SDGsの達成に向けた目標と取組の実施状況
1	<p>【目標】地球環境に考慮した現場内のムリ、ムダ、ムラの削減に努める。</p> <p>【実施状況】搬送用パレットの運用アプリを使いパレット管理を強化する事でムダな購入を減らす事が出来た。今後はパレットの個々の行き先回収状況を見える化にムリ、ムダ、ムラの削減に努めてまいります。</p>
2	<p>【目標】生産現場における女性が活躍できる環境づくりに努める。</p> <p>【実施状況】就業規則の整備も完了。ライフスタイルに合った雇用を実現させる為、意見交換会を開催し社内情報共有が出来た。</p>
3	<p>【目標】社員が心身の健康を保ち、長く働き続けられる環境づくりに努める。</p> <p>【実施状況】毎月1回禁煙日を設け運用致しました。又、喫煙者対象に年2回講習会を実施し禁煙者増に努めた。</p>

※宣言日(ウェブサイト掲載日)から3か月に満たない場合は、翌年度からの報告となります。

5. 環境問題への取り組み

当社は、富山県SDGs宣言において、環境に配慮したモノづくりを進め、職場内のムリ、ムダ、ムラの削減を進めることを掲げている。掲げた宣言内容については早期の取り組みを実践しており、またSDGs宣言実施状況の報告の中では、実績報告のみならず、今後の新たな取り組みについても明示している。



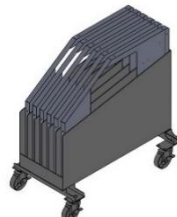
パレット管理

搬送用パレットの運用アプリを使いパレット管理をすることで、ムダな購入を抑制している。



梱包レスの取り組み

製品梱包に使用するフィルムの使用量削減に向けて、資材梱包の発注回数を抑制させている。



搬送治具の運用

製品・部材の搬送に治具を使用し、段ボールなどの梱包材の使用量を縮減させている。



再生資源の有効活用

製造過程で発生する資源ごみを屋根付きヤードで保管し、汚れ・不純物の混入を抑制しリサイクルを徹底している。

(3) 地域貢献活動

定期的に会社周辺の清掃活動を社員全員で実施し、当社の事業を行う地域の美化・環境保全に貢献している。

また「シンコーファームプロジェクト」として、工場立地法において必要となる敷地に対する必要緑地を農作地化し農作物の栽培を行い、収穫した野菜は子ども食堂への提供や従業員へ無料配布を行っており、環境と地域社会への貢献の両立を実現している。



地域清掃活動

定期的に会社周辺の清掃活動を、スタッフ全員で自主的に取り組んでいる。



シンコーファームプロジェクト

工場内の敷地の一部を利用して農作地化し、ミニファームを設置。収穫した野菜は子ども食堂への提供や従業員に無料配布している。



子ども食堂へ収穫野菜の提供

シンコーファームにて収穫した野菜を子ども食堂に提供し、地域の居場所づくりに貢献している。

6. インパクトの特定

(1) インパクトレーダーによるマッピング

株式会社富山第一銀行は、株式会社シンコーの各事業部門における事業内容やバリューチェーン分析等の結果をもとに、主要・関連業務を特定し、UNEP FIが推奨するインパクトマッピングを実施し、ポジティブインパクト及びネガティブインパクトの分布を調査した。

分布図中の「◆◆」は重要な影響があるカテゴリー、「◆」は影響があるカテゴリーを示しており、当社の事業活動における「◆◆」「◆」の影響を検討する。

国際産業標準分類	インパクトカテゴリー	川上の事業				当社の事業		川下の事業					
		【2410】		【2420】		【2511】		【2829】		【2819】		【2610】	
		Positive	Negative	Positive	Negative	Positive	Negative	Positive	Negative	Positive	Negative	Positive	Negative
社会	水(入手)												
	食糧												
	住居	◆										◆	
	健康・衛生		◆									◆	
	教育												
	雇用	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	エネルギー												
	移動手段												
	情報			◆									◆
	文化・伝統												
	人格と人の安全保障												
	正義・公正												
	強固な精度・平和・安定												
環境	水(質)		◆		◆		◆		◆		◆		◆
	大気		◆		◆		◆		◆		◆		◆
	土壌		◆◆		◆◆				◆		◆		◆
	生物多様性と生態系サービス												
	資源効率・安全性		◆◆		◆◆		◆		◆		◆		◆
	気候		◆		◆		◆		◆		◆		◆
	廃棄物		◆		◆		◆		◆		◆		◆
経済	包括的で健全な経済	◆		◆		◆		◆		◆		◆	
	経済収束												

当社の企画開発事業部における主要な業種について、バリューチェーン分析から、国際産業標準分類に則り、「第一次鉄鋼製造業（2410）」「第一次金属・その他非鉄金属製造業（2420）」「構造用金属製品製造業（2511）」「電子部品及び基盤製造業（2610）」「その他の特殊産業用機械製造業（2829）」「その他の一般機械製造業（2819）」を適用した。

インパクトマッピングにおいて特に影響が大きいと考えられるインパクトカテゴリーは、ネガティブでは「土壌」「資源効率・安全性」が挙げられた。

一定の影響があると考えられるインパクトカテゴリーは、ポジティブでは、「住居」「健康・衛生」「雇用」「情報」「包括的で健全な経済」、ネガティブでは、「健康・衛生」「雇用」「水(質)」「大気」「気候」「廃棄物」が挙げられた。このうち当社事業と関連性の高いカテゴリーを中心に検討する。

6. インパクトの特定

当社の主力事業である半導体製造装置フレームは売上高の約8割を占め、取引先である半導体製造装置メーカーの要請を受けて年々生産量を増加させており、今後も更なる増産要請を受けている。半導体製造装置及び当社の供給するフレームは、デジタル社会を支える半導体の製造にあたって必要不可欠な製品であり、日本また世界における半導体製造の増産に向けて当社製品の安定供給が求められる。

また半導体製造装置には高い精度と高剛性が要求されるが、人の手で加工する熟練の技術力と部材の切断・溶接・加工を行う最先端の生産設備の融合により、他社では提供困難である高い仕上がり精度の半導体製造装置フレームを当社は提供する。

今後も新たな工場の建設、最先端設備の継続的な導入、積極的な人材採用、充実したキャリアアップ・スキルアップにより増産体制を構築し、半導体製造装置フレームの生産を拡大させることで、サプライチェーンの中でデジタル社会の発展に寄与し、「情報」「包括的で健全な経済」のポジティブ・インパクトの増大に貢献する。

製造業における大きな課題として、工場稼働に伴うCO₂の排出や産業廃棄物などが環境への影響として挙げられる。当社は、環境マネジメントシステムにおける目標設定として、電気使用量の削減、産業廃棄物の排出量削減、OA紙使用量の削減、ガソリン使用量の削減の目標を掲げ、その達成に向けて取り組んでいる。特に、製造製品の不適合再手配品の削減を重要視しており、作り直しのため発生する使用資材・廃棄物の発生、工場稼働による電力の抑制に努めている。

富山県SDGs宣言においては、地球環境に考慮した現場内のムリ、ムダ、ムラの削減に努めることを掲げ、搬送用パレットの購入抑制や製品の梱包レスに取り組んでいる。また、地域環境に対する社会貢献活動として、会社周辺の清掃活動や、社内で栽培した野菜のこども食堂への提供を行っている。

以上の取り組みにより、環境面においては「資源効率・安全性」「気候」「廃棄物」におけるネガティブインパクトの抑制に努めている。

雇用においては、安定雇用による生計へのポジティブインパクトがある一方で、労働者の健康面と安全性のリスクがネガティブインパクトとなっている。

当社では「心と体の健康を大切に、楽しく働ける職場環境づくり」を目指し、ワークライフバランスの調和に向けて健康経営と働き方改革を積極的に取り組んでいる。実践具体的取り組みとしては、会社全体でのノー残業デー遵守に向けた行動、従業員向けの各種健康講習の実施や禁煙デーの実施、運動をする環境・機会を提供している。また女性活躍推進法に基づく女性の働きやすい環境づくり、キャリアアップ支援や、従業員のスキルアップに向けた資格取得支援などにより、「雇用」のカテゴリーにおけるポジティブ・インパクトの増大、及びネガティブ・インパクトの抑制に努めている。

6. インパクトの特定

(2) インパクトカテゴリーに対応するSDGsゴール

当社の売上高は全て日本における事業であり、日本のSDGsダッシュボードから当社のインパクトとの関係性について確認する。今回特定したインパクトと関連の高いSDGsのゴールは下記となる。



(3) 日本におけるインパクトニーズの確認

持続可能な開発ソリューションネットワーク（SDSN）に掲載されている日本のダッシュボードによると、大きな課題が残る項目が「赤色」、重要な課題が残る項目が「橙色」、課題が残るのが「黄色」、目標達成が「緑色」となる。

今回特定したインパクトと対応するSDGsのゴール7項目のうち、3項目が大きな課題が残る項目、2項目が重要な課題が残る項目、1項目が課題が残る項目である。日本に課題が残る項目が7項目中6項目該当していることから、日本における当社のインパクトは重要度が高いと判断する。

日本

経済協力機構加盟国



戻る 概要 指標 ファクトシート 政策への取り組み



ダッシュボード： ■ 大きな課題が残る ■ 重要な課題が残る ■ 課題が残る ■ 目標達成
動向： ↓ 減少 → 停滞 ↗ 緩やかに改善 ↑ SDGsの達成を順調に進めているまたは維持している
■ 情報がない ● トレンド情報は利用できない

(出典：SDGsダッシュボード)

6. インパクトの特定

(4) インパクトの特定

以上を踏まえ、当社のインパクトを下記のように特定した。

- **当社事業を通じたサプライチェーンへの貢献**
- **地球環境保全への取り組み強化**
- **従業員が働きやすい職場環境の提供**

(5) 特定したインパクトと富山第一銀行との方向性の確認

特定したインパクトと富山第一銀行のサステナビリティ方針と方向性が同じであることを確認する。

今回特定したインパクトは「**当社事業を通じたサプライチェーンへの貢献**」「**環境負荷低減に向けた取り組みの強化**」「**従業員が働きやすい職場環境の提供**」である。

富山第一銀行では、サステナビリティ方針のなかで、「1.地域経済の持続的な成長」「2.地域社会の持続的な発展」「3.環境保全」「4.健全な企業経営」の4点をサステナビリティを巡るマテリアリティ（重点課題）としている。

「**当社事業を通じたサプライチェーンへの貢献**」では「1.地域経済の持続的な成長」「2.地域社会の持続的な発展」という観点で、「**環境負荷低減に向けた取り組みの強化**」では「3.環境保全」の観点で、「**従業員が働きやすい職場環境の提供**」では、「4.健全な企業経営」の観点で方向性が一致する。

以上より、本ポジティブ・インパクト・ファイナンスに取り組むことで、環境問題や地域社会・経済を取り巻く課題に対して持続可能な社会の実現に貢献し得る資金の提供が可能となり、本ファイナンスを通じてSDGs達成に向けた取り組みの支援を目指す。

7. KPIの設定

① 半導体製造装置フレームの供給を通じた経済・社会への貢献

当社は企業理念にて「お客様のニーズに応え、信頼性の高い製品をサービスを提供し、『ものづくり』に挑戦する」ことを掲げている。

人の手で加工する技術とIoTの融合により、板金の鍛圧、鋼材の溶接組立をコアテクノロジーとし、半導体製造装置に不可欠な高精密度のフレームを提供している。

デジタル社会を支える重要基盤である半導体の生産量は今後も更なる拡大が見込まれ、当社の技術・製品提供の拡大は必要不可欠なものであり、当社の事業活動は、「情報」「包括的で健全な経済」のポジティブインパクトの拡大に貢献するものである。

項目	内容
インパクトの種類	社会面・経済面におけるポジティブ・インパクトの拡大
インパクトカテゴリー	「情報」「包括的で健全な経済」
対応方針	半導体製造装置フレームの供給拡大 品質の高い製品供給を行うための社内体制整備
K P I	・ 2028年5月期までに売上高15%増加 (2023年5月期 売上高 47億6,180万円)

7. KPIの設定

② 地球環境保全への取り組み強化

当社は企業理念にて「地域の活動や社会問題に取り組み、貢献する」ことを掲げている。

環境マネジメントシステムにてISO14001の認証取得し、環境に関する方針や目標を設定し、達成に向けて取り組んでいる。

製造製品における不適合再手配品の削減を重要視しており、作り直しにより発生する使用資材・廃棄物の発生、工場稼働による電力の抑制に努めている。また、社内で栽培した野菜をこども食堂へ提供するなどの社会貢献活動や、地域清掃活動への参画により環境に貢献する取り組みを行っている。

以上から「資源効率・安全性」「気候」「廃棄物」のインパクトカテゴリーにおけるネガティブインパクトを抑制していると評価ができ、今後も継続した取り組みを期待する。

項目	内容
インパクトの種類	環境面におけるネガティブ・インパクトの抑制
インパクトカテゴリー	「資源効率・安全性」「気候」「廃棄物」
対応方針	不適合再手配品削減による資材・廃棄物・電力の抑制 環境問題への取り組み意識の向上
K P I	<ul style="list-style-type: none">・ 不適合再手配品の削減 2028年まで毎年前年比3%削減・ 環境に関する社会貢献活動の取り組み開示

7. KPIの設定

③ 従業員が働きやすい職場環境の提供

当社は、企業理念にて「働くスタッフひとりひとりの可能性や個性を生かし、体と心の健康を保ち、明るい会社づくりをする」ことを掲げている。

ワークライフバランスの調和を実践すべく、健康経営と働き方改革を積極的に導入しており、健康に関する従業員向けの講習の実施、運動・リフレッシュ施設を社内に設置し就業時間内のアクティビティ活動を行うなど、従業員の健康に配慮した環境が構築されている。

また、育児休業の取得推進や育児短時間勤務制度の整備、女性管理職育成研修などの取り組みにより、女性が働きやすくキャリアアップできる社内の体制となっている。

従業員の健康に配慮し、多様な人材が働きやすい環境が整備されており、経済・社会にとって非常に重要な点だと評価できる。

項目	内容
インパクトの種類	社会面におけるポジティブ・インパクトの拡大 社会面におけるネガティブ・インパクトの抑制
インパクトカテゴリー	「雇用」
対応方針	従業員が「心と体の健康を大切に楽しく働く」ことができる職場環境づくり
KPI	<ul style="list-style-type: none">・管理職に占める女性割合 2025年まで20%以上を維持 (2022年実績：22%) *2025年にKPIの再設定を予定する・ノー残業デーの遵守率 2028年まで毎年100%を達成 (2022年実績：99.7%)・育児休暇取得率 2028年まで毎年100%を達成 (2021年実績：100% 2022年：該当者なし)

8. 管理体制とモニタリング

(1) インパクトの管理体制

当社では、本ポジティブインパクトファイナンスに取り組むにあたり、大石英明様が陣頭指揮を執り、社内の業務や諸活動等を棚卸し、事業活動とインパクトレーダーやSDGsとの関連性、KPIの設定について検討を重ねた。

本ポジティブインパクトファイナンス実行後においても、管理責任者である大石英明様の指揮のもと、管理部が中心となって、KPIの達成に向け、課題の抽出、対策の検討、施策の実行を行なう。

最高責任者	代表取締役 中川真太郎
管理責任者	専務取締役 大石英明
管理部署	総務企画部

(2) モニタリング方法

本ポジティブインパクトファイナンス設定したKPIの達成及び進捗状況については、富山第一銀行と当社とで定期的に面談の場を設け、共有する。本面談は少なくとも年1回実施するほか、日頃の情報交換や営業活動の場等を通じて実施する。

富山第一銀行からは、KPI達成に必要な資金およびその他ノウハウの提供あるいは富山第一銀行の持つネットワークから外部資源とマッチングすることで、KPI達成をサポートする。

モニタリング期間中に達成したKPIに関しては、達成後もその水準を維持していることを確認する。なお経営環境の変化などにより、KPIを変更する必要がある場合は、富山第一銀行と当社が協議の上、再設定を検討する。

注意事項・免責事項

1. 本評価書は、富山第一銀行が株式会社シンコーから提供された情報や独自に収集した情報に基づく現時点での計画又は状況に対する評価で、将来におけるポジティブな成果を保証するものではありません。
2. 富山第一銀行は、本評価書を利用したことにより発生するいかなる費用または損害について、一切責任を負いません。

● 本件に関するお問い合わせ先

株式会社富山第一銀行

法人事業部 コンサルティングチーム

〒930-8630

富山市西町5番1号（TOYAMAキラリ7F）

TEL (076) 461-3871